

2.5D[®]

放熱、シールド、モジュール化、及び
シグナルインテグリティを改善できる
キャビティテクノロジー

Thank you for visiting
the AT&S booth.
Visit ats.net for more
information.

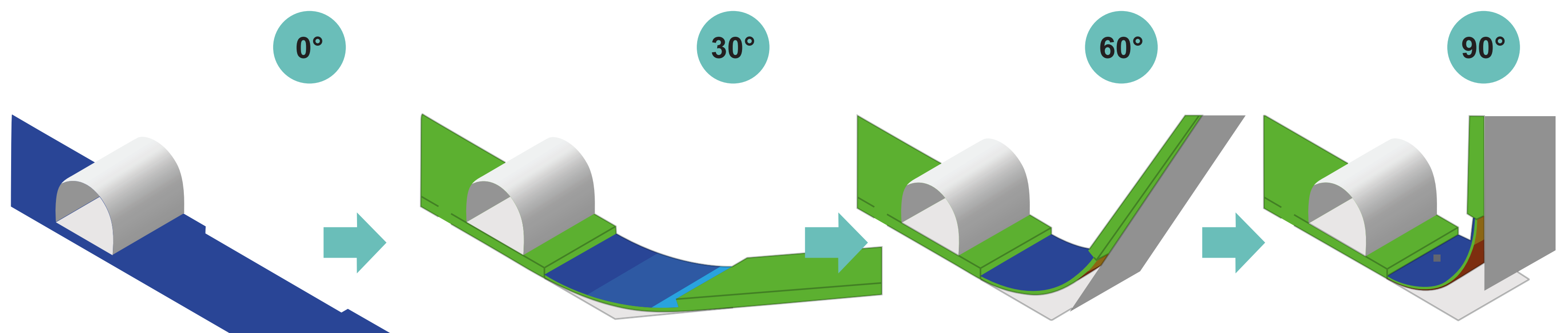
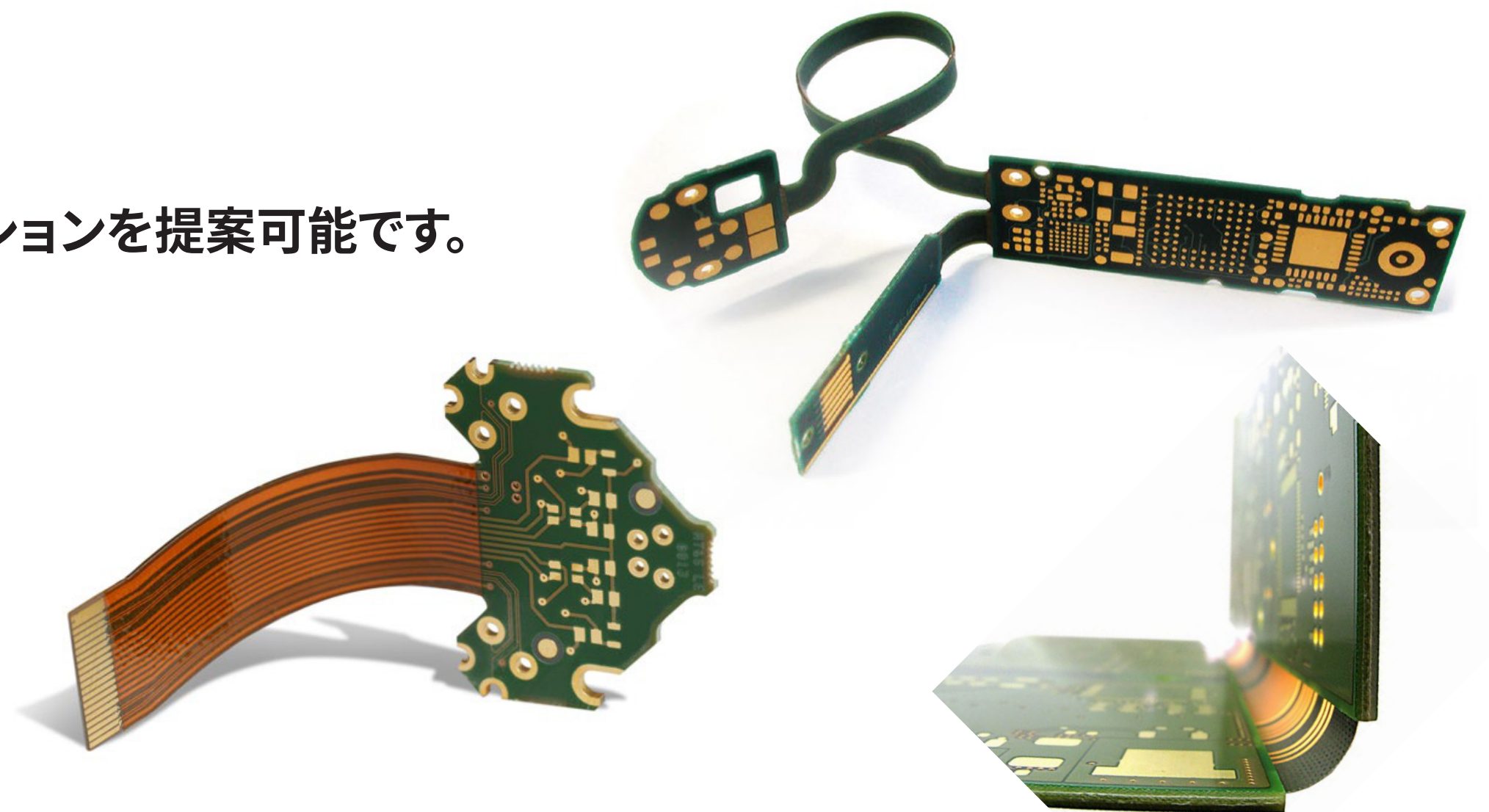


2.5D[®] セミフレックス

ポリイミドベースのリジッドフレキ基板に対し低コストなソリューションを提案可能です。

- 基板曲げ後に固定して使用される静的なアプリケーションに最適
- 車載、ストレージ向けなど高信頼性要求での量産実績
- 応力シミュレーションにて最適な折り曲げを実現

曲げ回数	Max. 5 times
曲げ部長さ	Min. 7mm (曲げ角度<=90°)
	Min. 10mm (曲げ角度90~180°)
曲げ部層数	1 or 2 layer

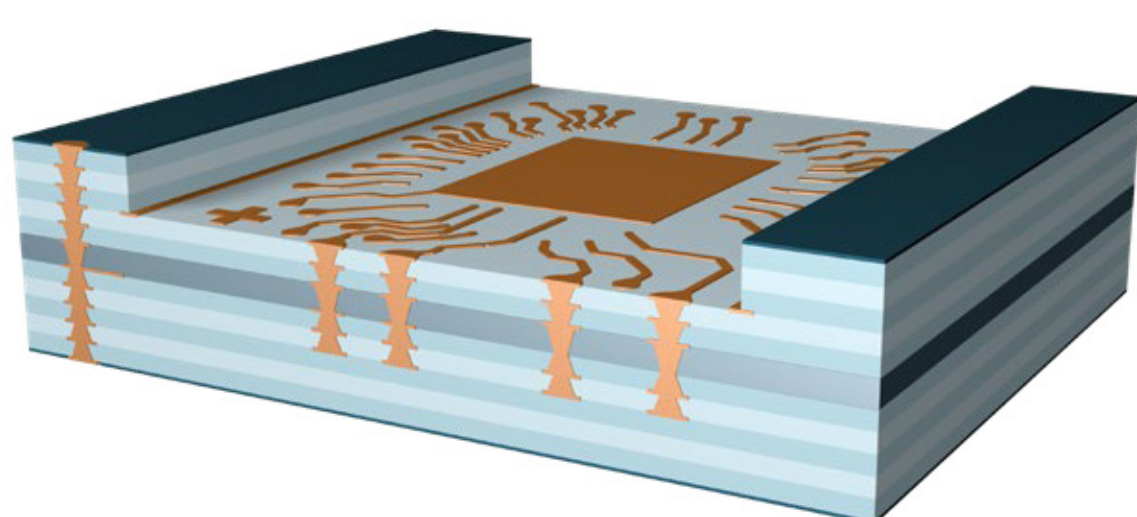
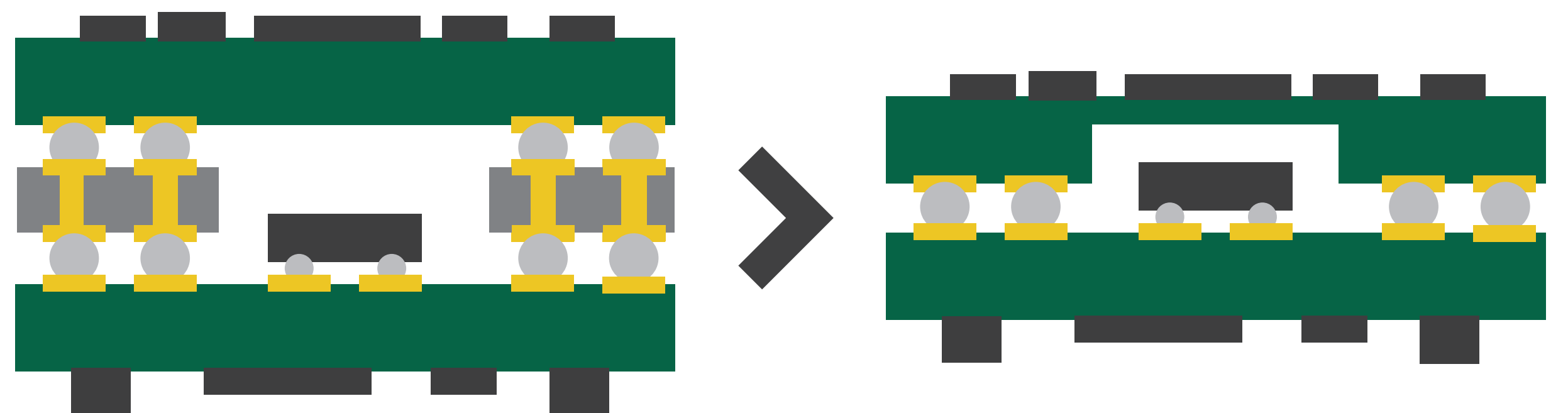


2.5D[®] キャビティ

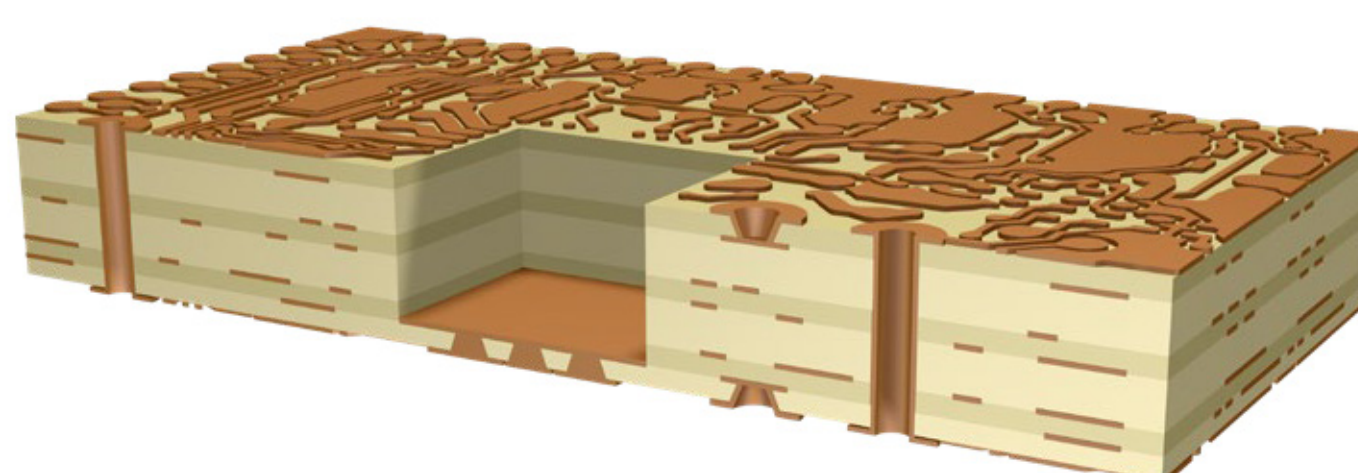
キャビティ基板による基板層数削減を始めとして、電気特性、熱特性にも効果的なソリューションを提案可能です。

- インターポーザレス構造の提案
- キャビティ内実装、表面処理、レジスト塗布が可能
- 自由度の高いキャビティ形状設計

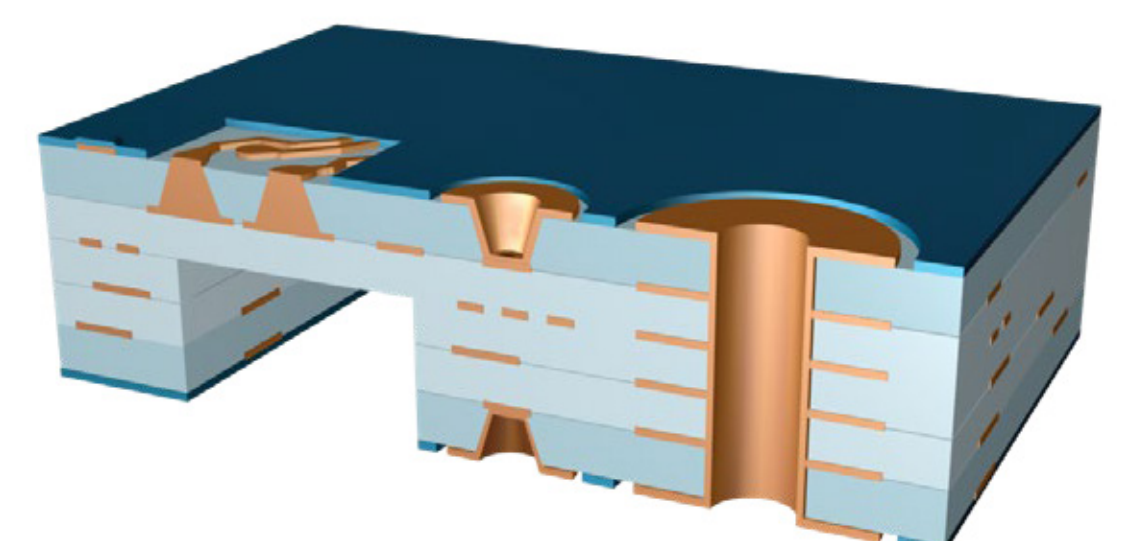
最小キャビティサイズ	1x1 mm
最大キャビティサイズ	Unlimited



部品実装時の低背化



放熱経路の短縮による熱抵抗の低減



信号特性の改善